



芝普企業股份有限公司 E-CHEM ENTERPRISE CORP.

Sep. 25, 2025

免責聲明

本簡報及本公司於同一時間發布之相關資料，包含歷史資訊以及管理階層對未來業務發展之預測性說明，係基於芝普企業股份有限公司（以下簡稱「本公司」）目前可得資訊與主、客觀判斷所作之評估。

本簡報中所揭露之未來展望，涉及未來事件與營運績效之預測，可能受到多項風險與不確定因素之影響，導致實際結果與預期產生重大差異。該等風險與因素可能包括但不限於產業景氣變動、國內外經濟狀況、市場競爭、原物料價格波動、法規變動、技術進展與其他非本公司可掌控之因素。

本公司不保證本簡報所載之資訊（包括對未來的展望）為最新、完整或無誤，並無義務就其內容之任何變動進行更新、修正或重新公告。

本簡報中所載之合併財務資訊如經會計師查核或核閱，將另行註明；若無註明，則為管理階層編製之自結數據，僅供參考之用。詳細財務資訊請參閱本公司公開發布之財報及相關查核報告。

本簡報內容僅供說明及參考之目的使用，未經本公司書面同意，任何第三人不得擅自引用、節錄、轉載或散佈本簡報之全部或部分內容。

= 簡報大綱

CONTENTS



股票代號 7858

01

關於芝普
About E-Chem

02

產品及市場
Market & Products

03

未來發展
Future Plan

04

經營績效
Business Performance



股票代號 7858

關於芝普

About E-Chem

01



About E-Chem

股票代號 7858

關於芝普企業

成立時間
1989 年

董事長
林士堯

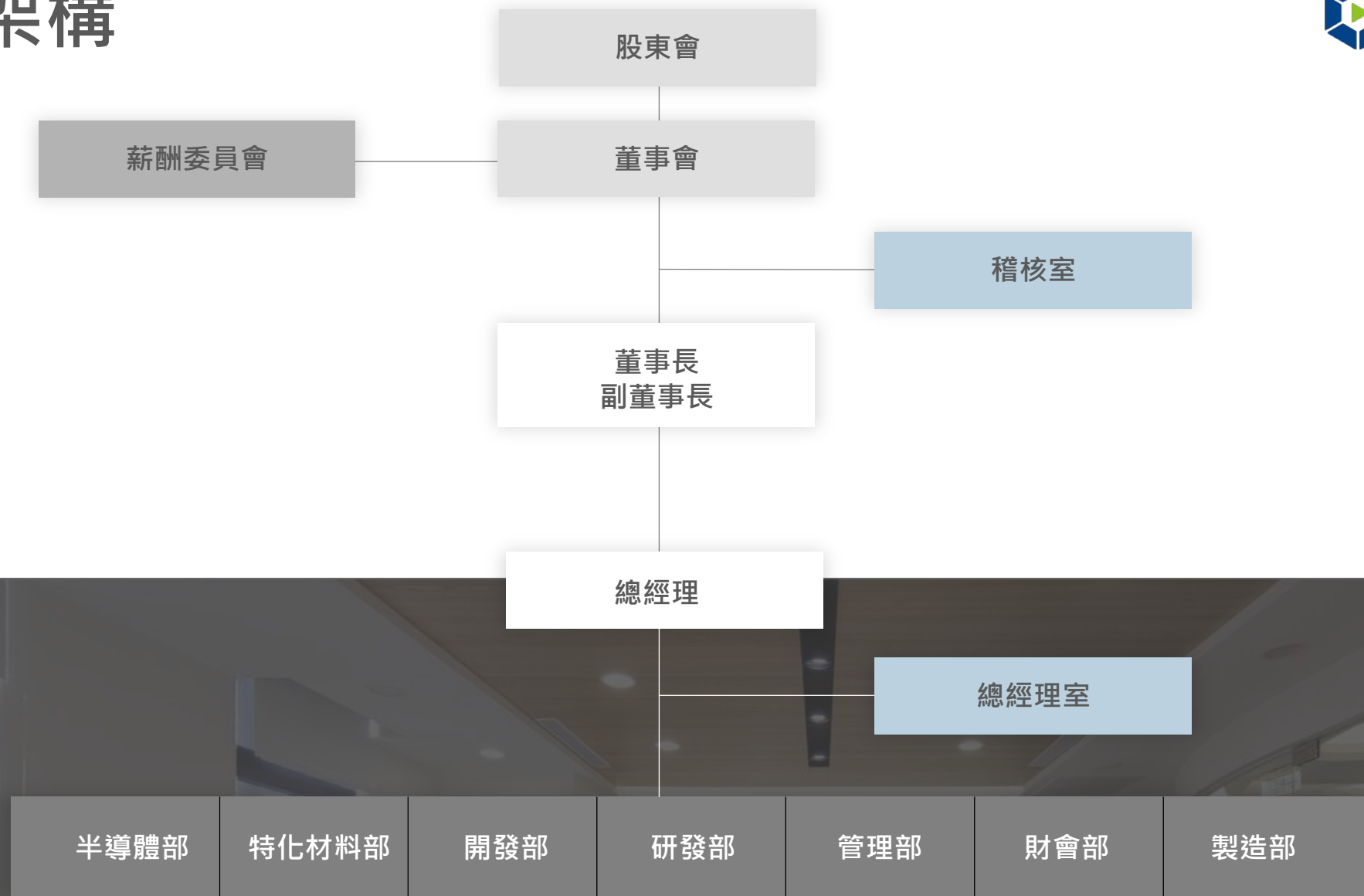
員工人數
約108人

資本額
2 億 2237 萬元

主要產品
半導體製程用化學品及材料 72%
特化學品及材料 28%

提供優質產品與服務，
滿足客戶需求，
專精於電子化學與功能材料的解決方案。

組織架構



經營團隊



股票代號 7858

董事長 林士堯

中原大學應用物理所

欣興電子(股)公司董事長資深特助兼明興光電執行長
恆顯科技(股)公司總經理、時緯科技(股)公司總經理
奇美光電(股)公司副總經理、技迪科技(股)公司董事
台康科技(股)公司董事長、統寶光電(股)公司資深副總經理

副董事長 王尊武

國立清華大學化學系

芝普企業(股)公司董事長
芝普企業(股)公司董事長兼總經理

總經理 趙文義

國立清華大學科技管理研究所

冠捷科技有限公司上海總經理
禾鈺(股)公司臺灣負責人/研發協理

協理 陽若欽

中原大學化學系

宏逸(股)公司業務主管
迪凱企業(股)公司業務主管

協理 劉小茜

中央大學企業管理所

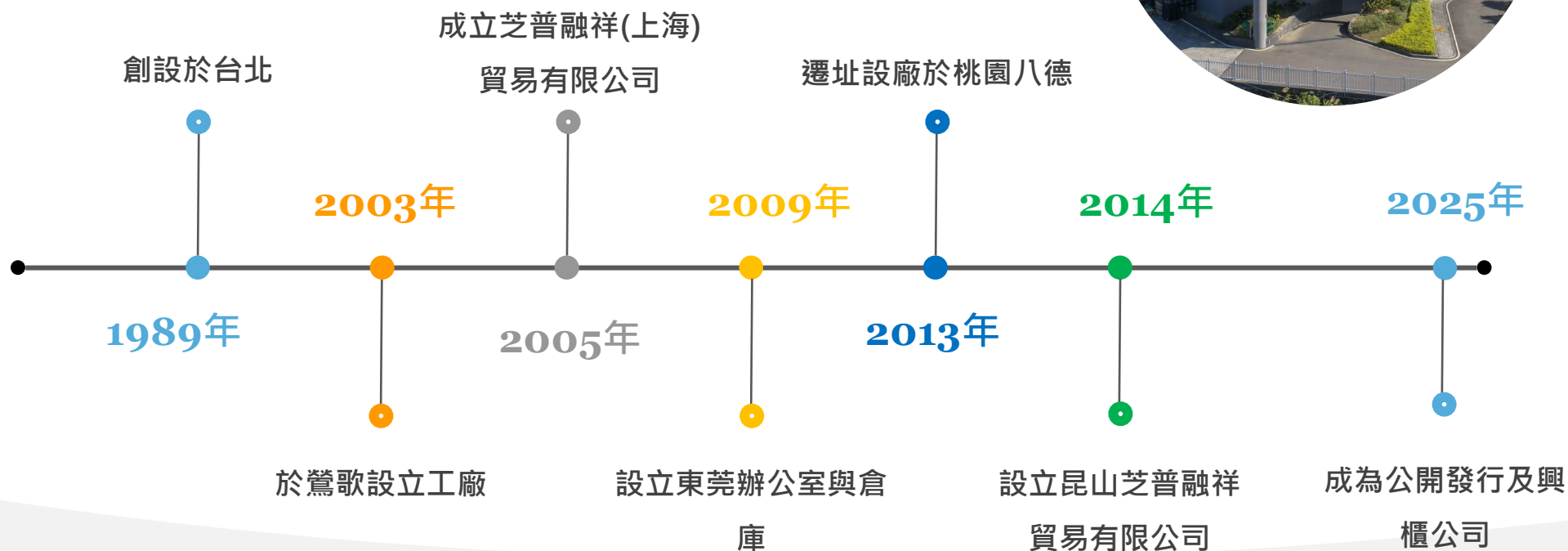
欣銓(股)公司專案副處長/欣銓南京副處長
安成國際藥業(股)公司行政暨財會處協理
中華商業銀行企業金融授信部襄理

研發副理 魏郡菽

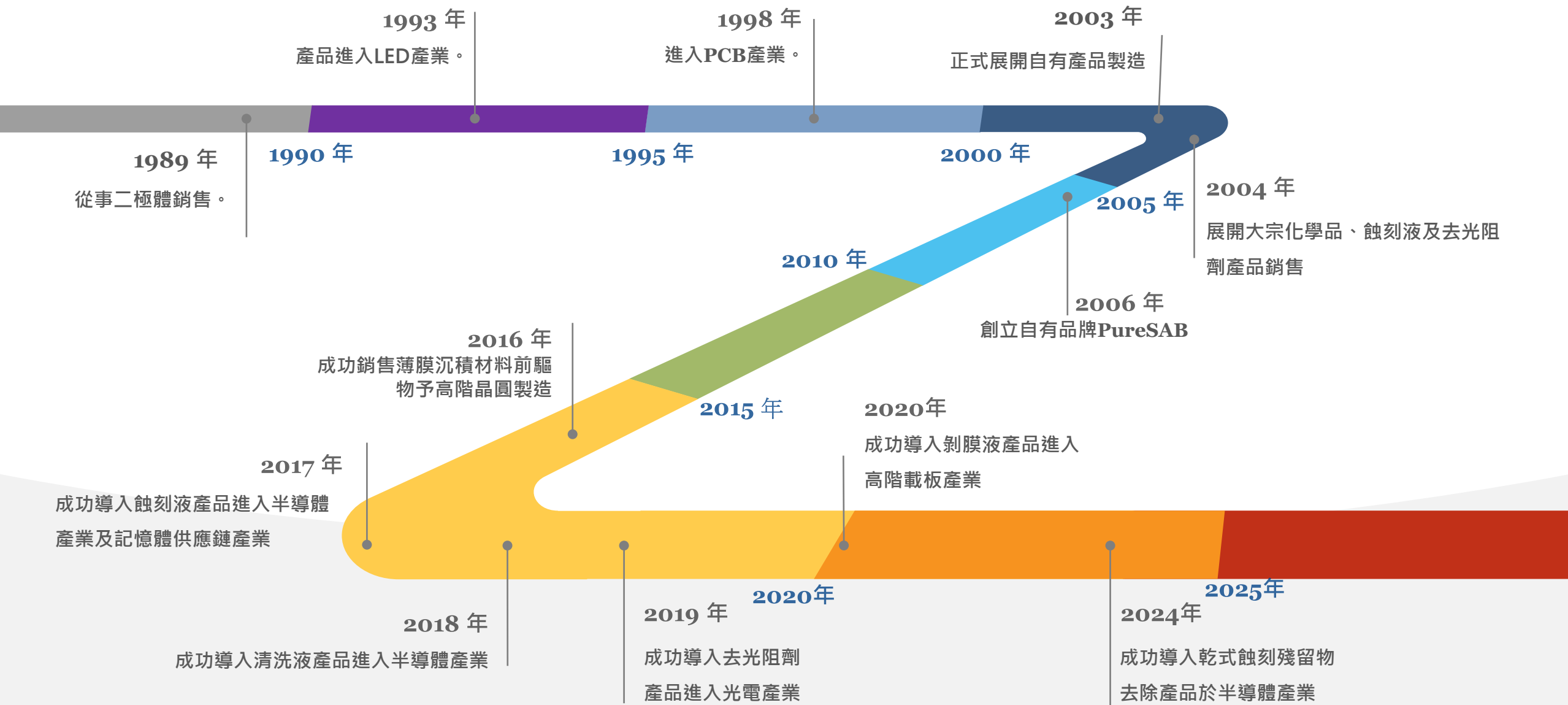
國立臺灣大學高分子科學與
工程學博士

達興材料(股)公司資深研究員

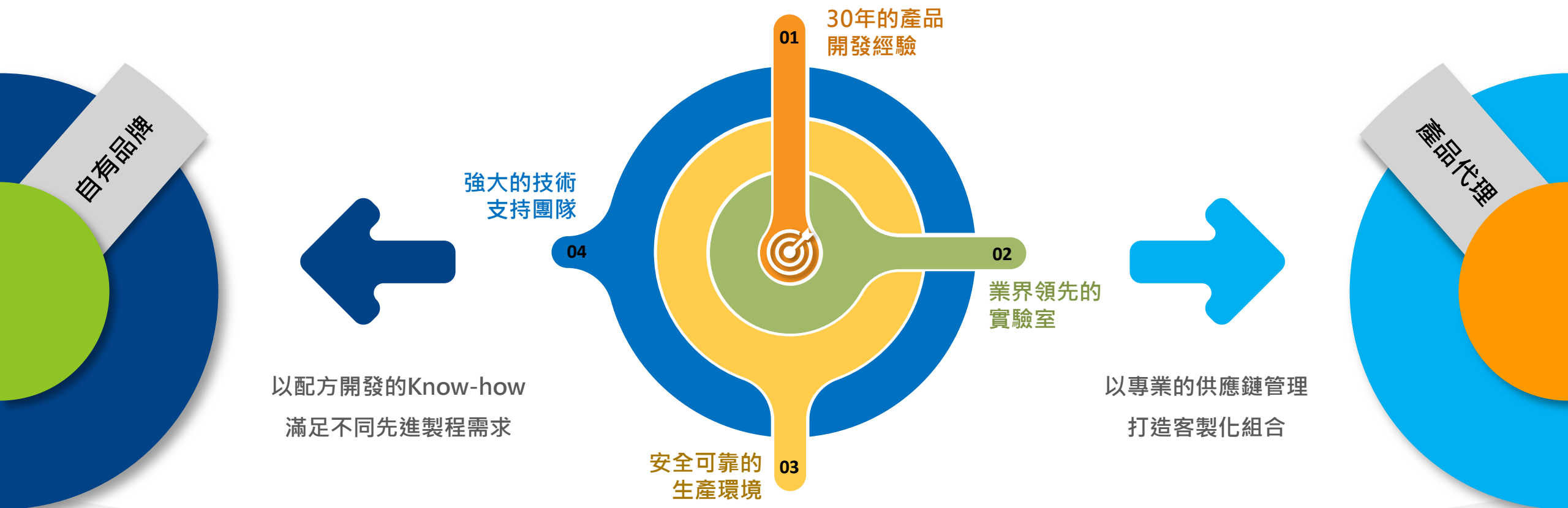
公司大事紀



發展沿革



二 核心能力與商業模式



聚焦高階製程與綠色產品發展，厚植客製化配方能力、滿足客戶先進製程需求。以提供最好的在地技術服務、快速供應鏈反應。

一 打造專業化學材料平臺

- 高純度化學品
- 前驅物
- 電子級/工業級化學品

製程用
化學品

特用
化學品

貴金屬
化學品

表面處理
化學品

- 精細化學品

- 蝕刻
- 去光阻
- 清洗
- 電鍍/無電鍍

產品平臺

主要客戶領域

其他產業

半導體

二極體

晶圓代工

化合物半導體

記憶體

封裝

微機電

LED/MINI LED

特化

配方藥水商

高階載板

被動元件

新能源

熱管理

軟板

生技

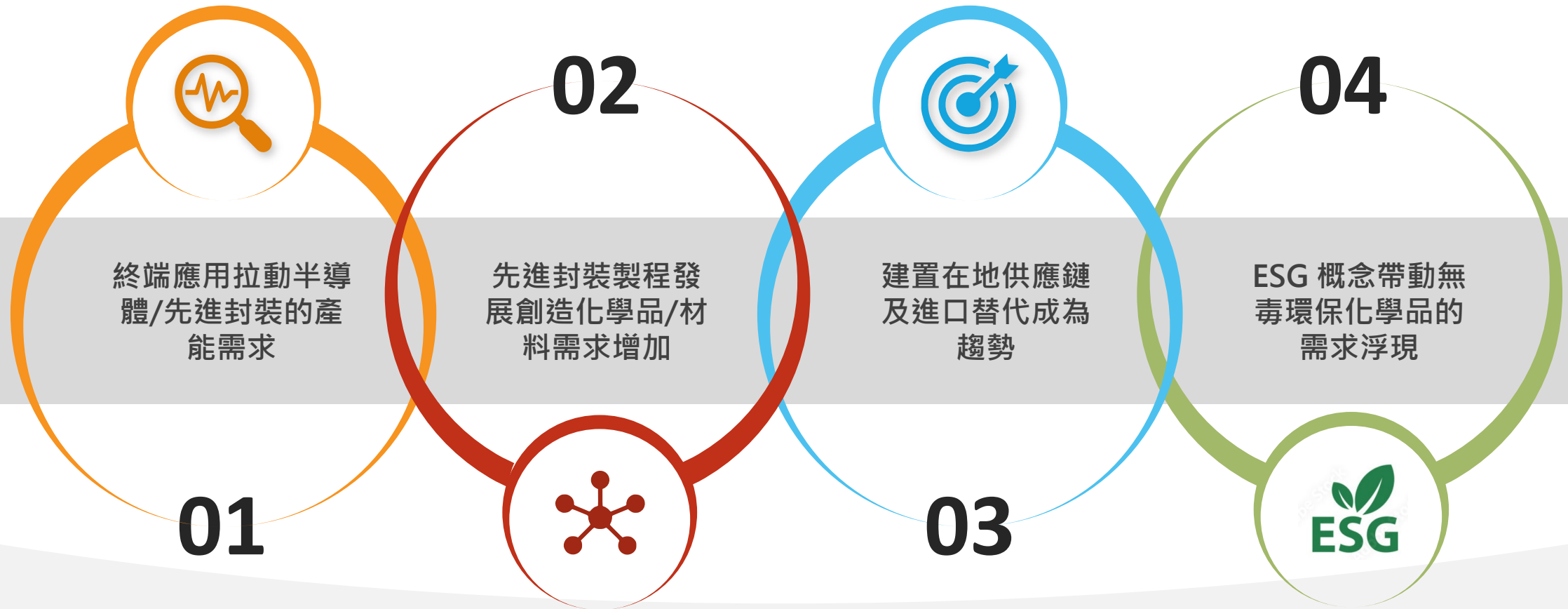
產品與市場

Market Information

產品銷售及布局

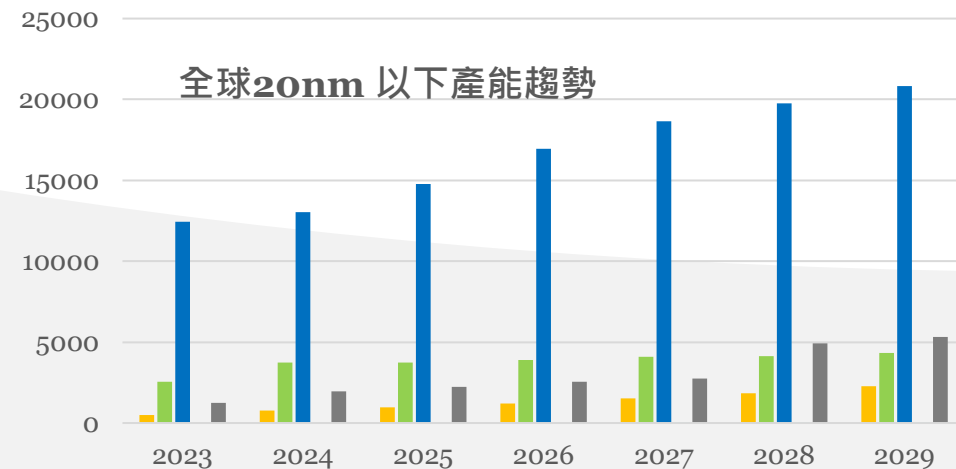
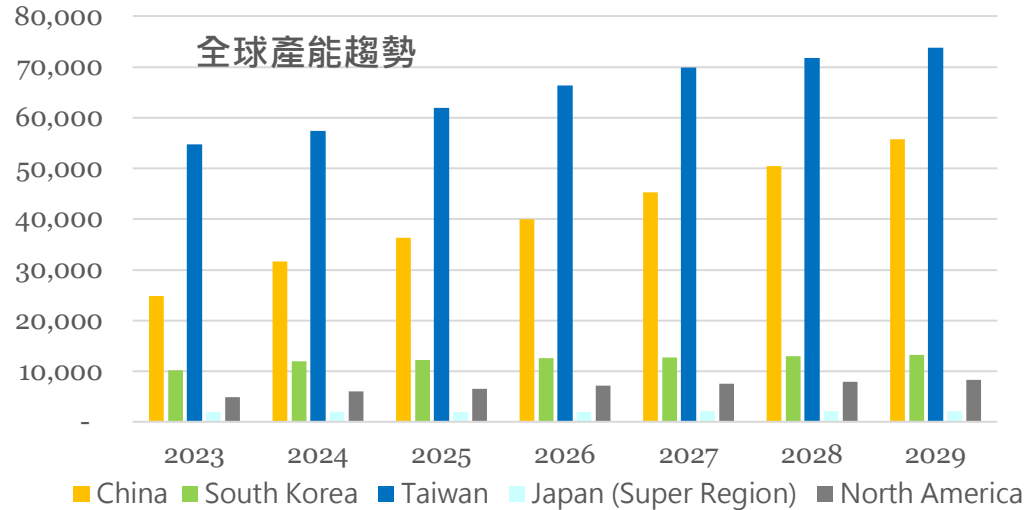


市場機會與成長動能



二 半導體及先進封裝產能趨勢

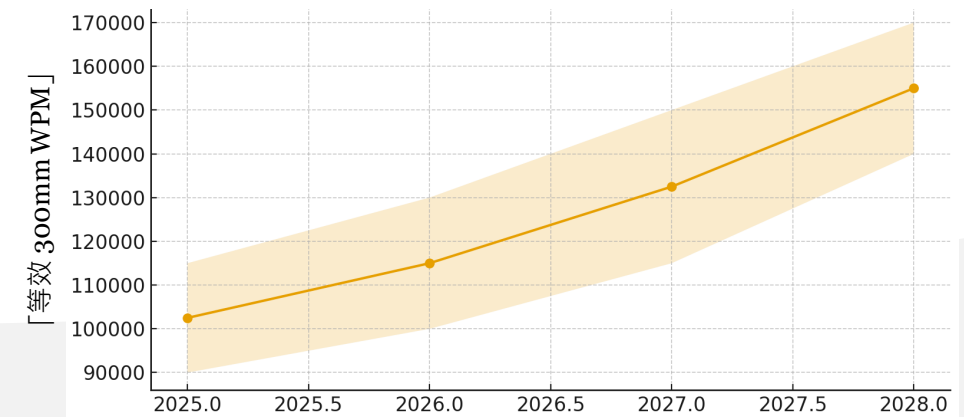
半導體



Source: Gartner (芝普整理)

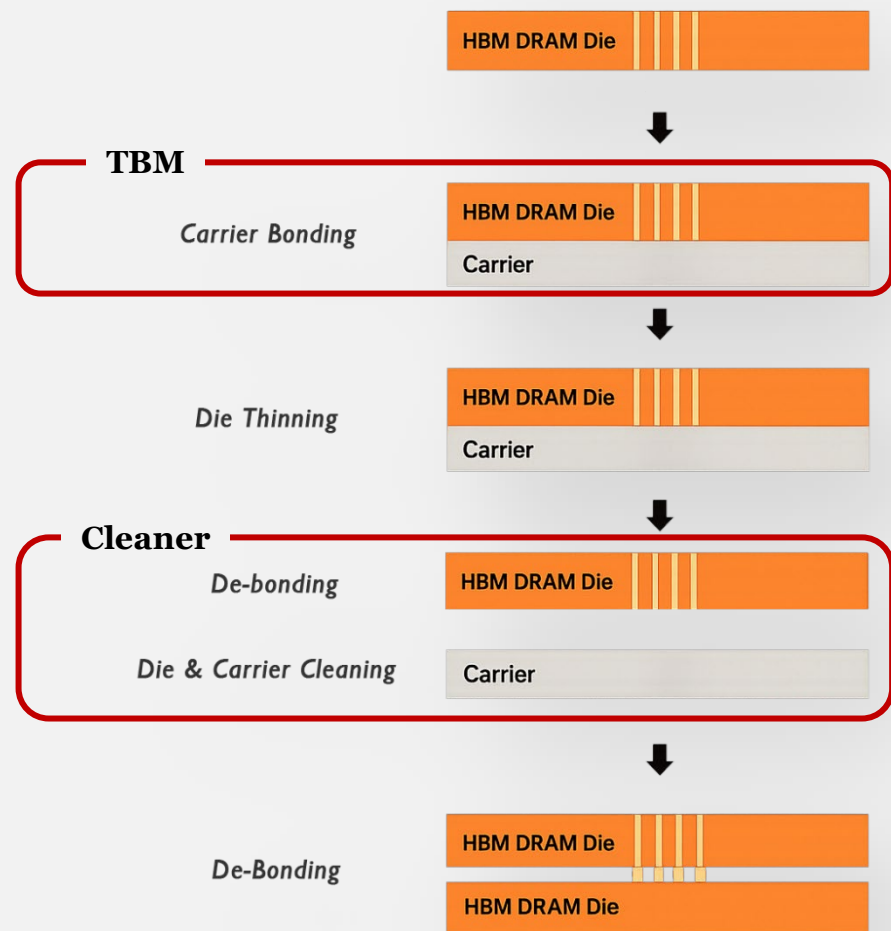
先進封裝

- 根據 Yole Intelligence 預測，先進封裝市場規模將自 2024 年的約 380 億美元，於 2030 年成長至約 790 億美元，年複合成長率達 12.7%，展現穩健上升趨勢。
- 根據研調機構國際數據資訊 (IDC) 2024年12月底發布的「2025年全球半導體市場八大趨勢預測」。台積電CoWoS產能持續倍增，預計將從2024年的33萬片擴充至2025年的66萬片。



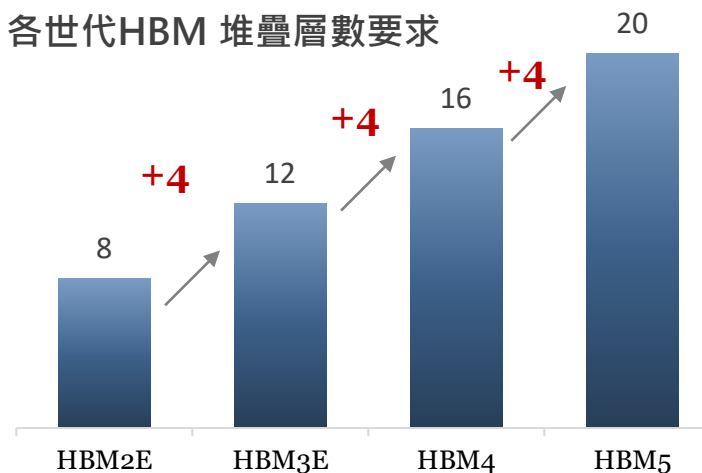
Source: 網路資料。2025-2026 以公開報導為主；2027-2028 為基於已公告投資與擴產時程的推估 (芝普整理)

HBM帶動濕製程化學品/材料需求



Note : HBM(High Bandwidth Memory)

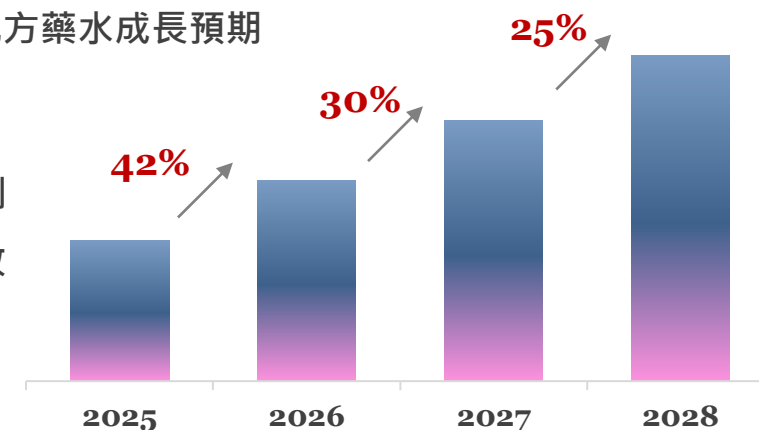
各世代HBM 堆疊層數要求



隨著堆疊層數增加，TBM/蝕刻/清洗等需求也隨之增加。

蝕刻配方藥水成長預期

芝普供應的蝕刻用添加劑已通過客戶驗證，逐步放量中。



清洗液



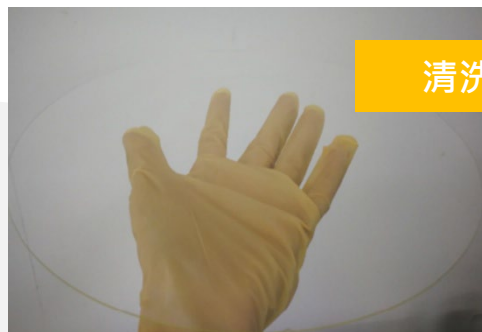
股票代號 7858

- 隨著晶片製程技術不斷微縮，對超潔淨晶圓的要求越來越高，需要更高效、更精密的清洗劑來去除極小的顆粒和殘留物。
- 芝普開發的先進封裝清洗劑，**已通過客戶驗證**，清洗速度及效果明顯優於同業(時間縮短達80%)。

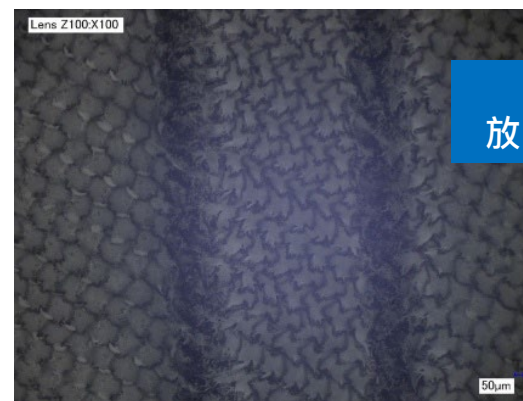
Features	Process Temp(°C)	Application	Excellent selectivity
1. Low corrosion rate on substrate glass 2. Excellent solubility 3. Fast removal speed	22~70	TBM	Glass loss <0.01mg/cm ²



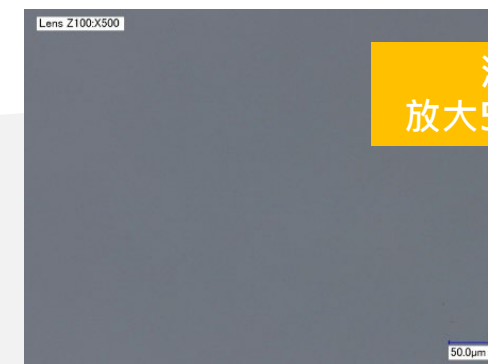
清洗前 相片



清洗後 相片



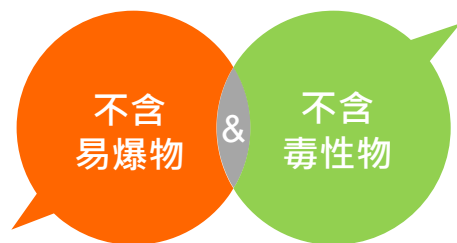
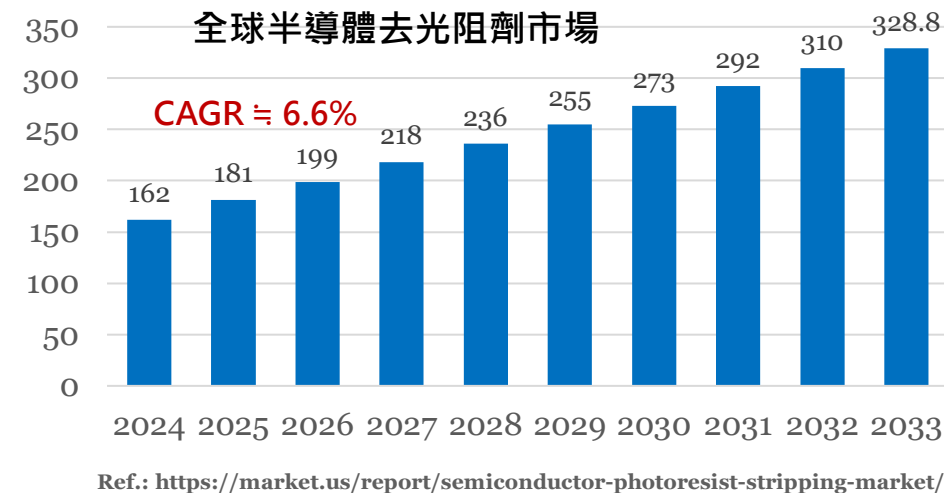
清洗前
放大500倍 相片



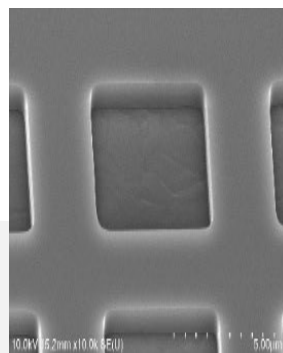
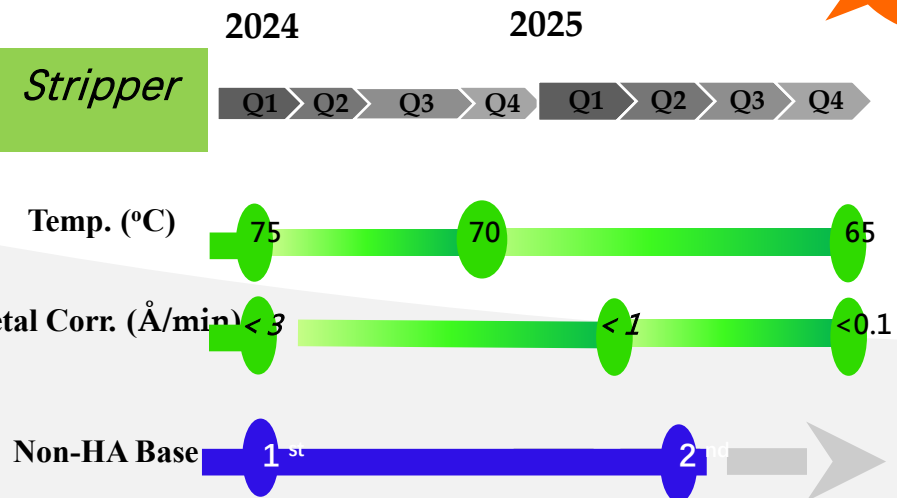
清洗後
放大500倍 相片

去光阻劑

- 2024年市場規模估計約為5.4億至5.78億美元(~NTD162億)，預計到2033/2034年將達到0.97億至10.96億美元(~NTD328億)，複合年增長率 (CAGR) 約為6.6%至6.7%。
- 芝普專注於開發綠色環保型去光阻劑，專注於不含羥胺 (Hydroxylamine)、TMAH、DMSO等危害物質的替代產品開發。



Hydroxylamine free

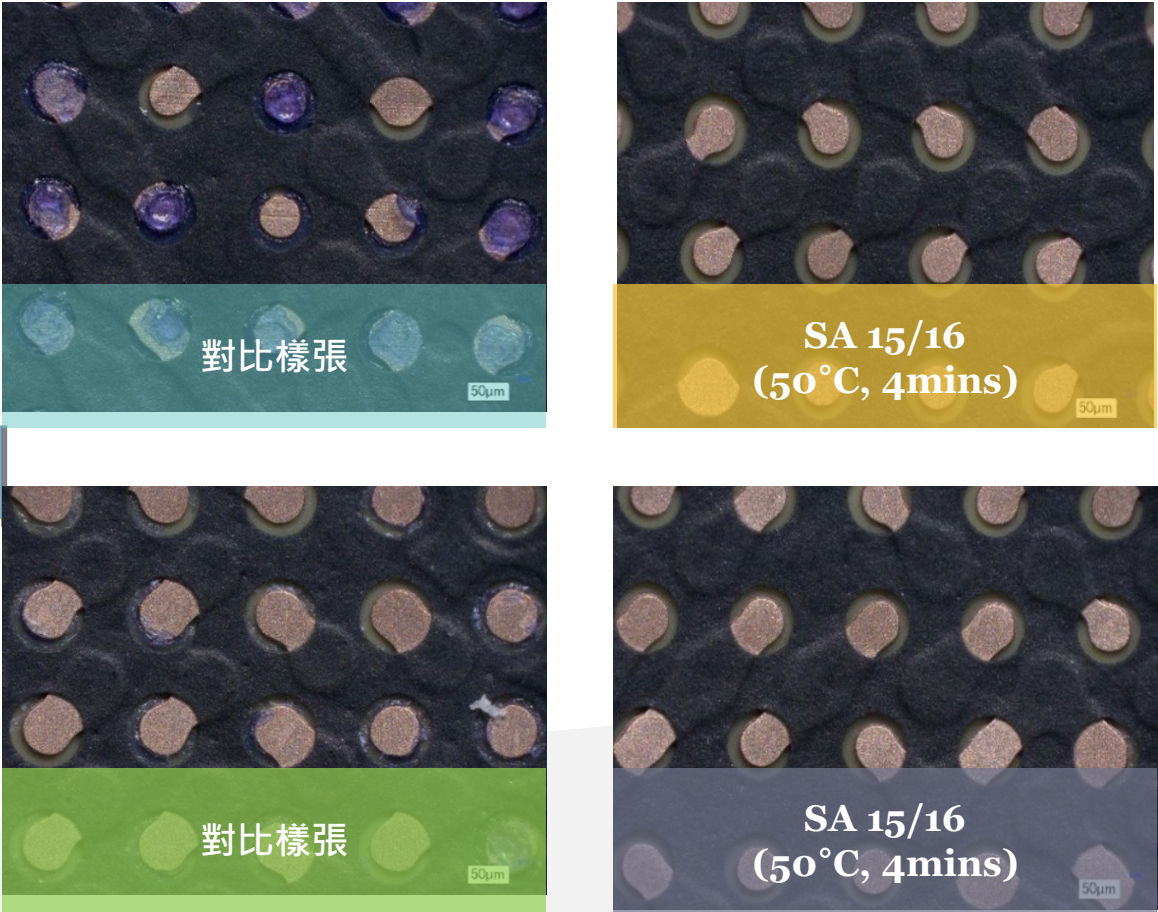


面向	D 社	芝普
清洗液技術	HDA® 技術 (含羥胺)	無羥胺、低金屬殘留環保配方
市場定位	高效去除蝕刻殘留，適用於金屬層	高階製程客製化能力、綠色環保

高階載板製程用環保剝膜液

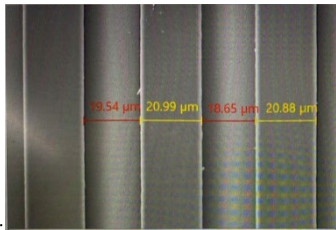
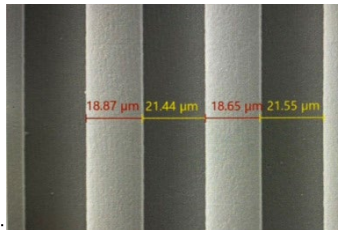
- 芝普所開發的SA雙劑碎膜型剝膜液，不含急毒性物質，操作風險較低。並具有銅面防止變色能力佳、極細線路及封閉區乾膜去除能力佳、廢水處理容易等優點
- 產品已經通過高階載板大廠驗證，持續放量中。

清洗結果對照表



Maker	L/S	Toxicity	Weakness
M社 & K社	<8/8	  	EHS risk ESG fail
E-Chem	<8/8		

二 高階載板製程用環保剝膜液

剝膜前觀察		E-Chem NON-TMAH Base	TMAH Base
銅腐蝕率 [Å/min]	濺鍍銅	<1	58
	化鍍銅	7.9	49
線路外貌			
粗 糙 度	Ra(um)	0.024	0.020
	Rz(um)	0.204	0.152

1. 對應不同銅材E-Chem均表現出良好的低銅腐蝕率
2. 剝膜後對銅面粗糙度影響較低，可降低或改善線路蝕刻後銅面粗糙度增加幅度
3. 對應含TMAH 的剝膜液, COD 值下降約60%。對應不含TMAH 的剝膜液, COD 值下降約45-50%。
廢液處理成本同比下降。

未來發展

Future Plan

未來研發重點

先進封裝製程解決方案

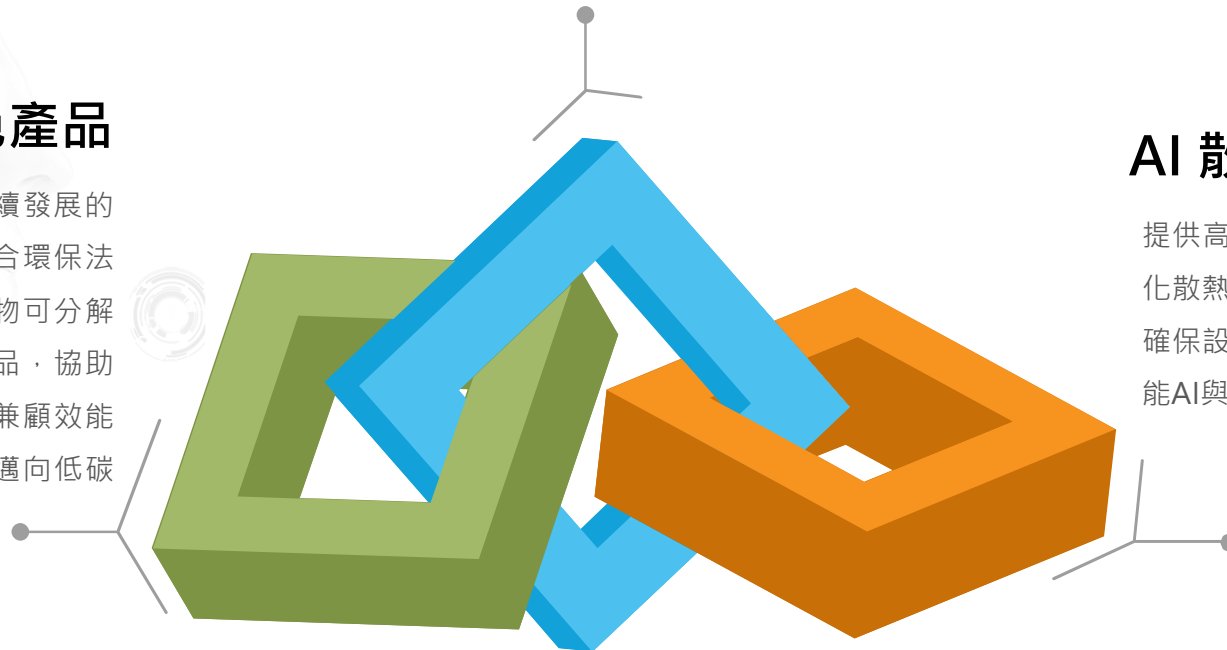
因應先進封裝技術對精密度與環保需求的提升，提供完整的製程用材料解決方案，涵蓋先進製程用蝕刻液、環保低危剝膜液，以及專為先進封裝設計的暫時接著膠與高效清洗劑，協助客戶提升製程良率、降低環境衝擊，並強化整體製造彈性與競爭力。

綠色產品

在全球推動淨零碳排與永續發展的大趨勢下，致力於開發符合環保法規、低毒性、可回收或生物可分解的綠色材料與製程用化學品，協助客戶實現綠色製造，打造兼顧效能與環保的解決方案，共同邁向低碳未來。

AI 散熱解決方案

提供高導熱材料、低熱阻介面材與模組化散熱結構，協助客戶優化熱管理設計，確保設備長時間穩定運行，並支援高效能AI與邊緣運算需求。



二 未來經營發展方向

深化東南亞、韓國與中國業務，善用既有供應鏈優勢，拓展全球佈局

關注高成長、具潛力的新興產業的材料需求，拓展新機會



厚植核心能力建構，加大研發投入及人才培養，強化競爭力

優化製程與生產能力，拓展新業務模式，釋放新廠潛能

經營績效

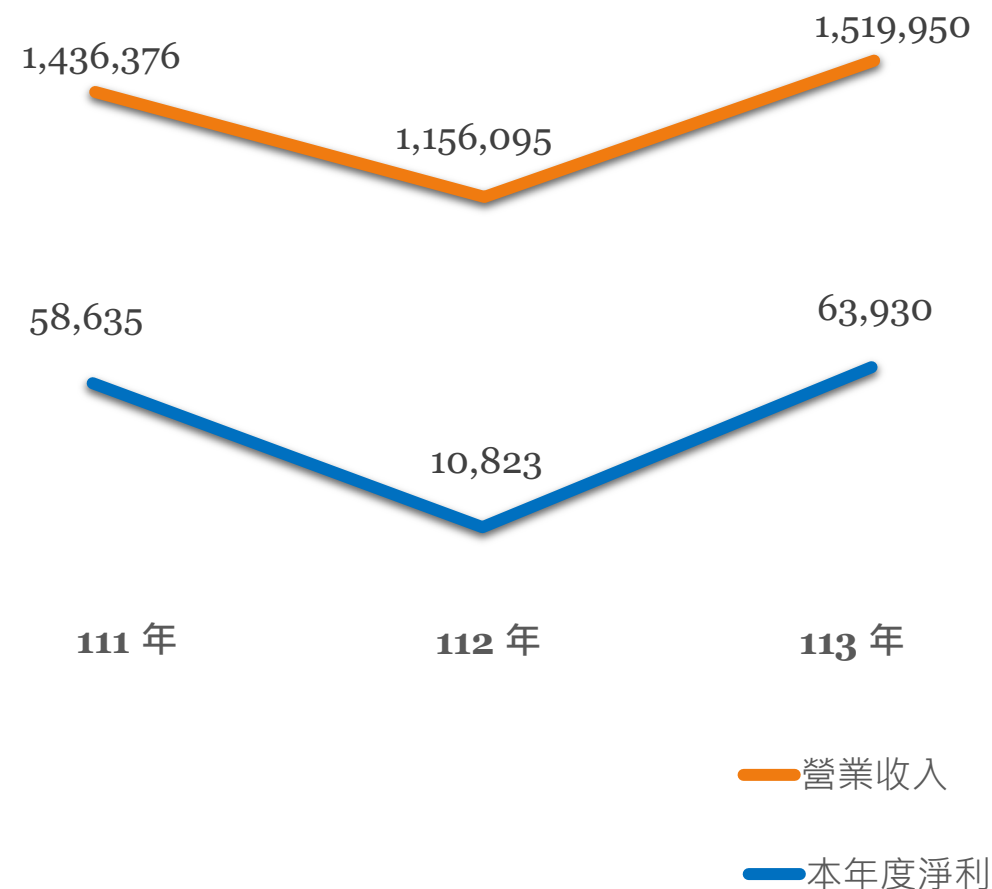
Business Performance

二 營收與獲利

單位：新台幣仟元



	111年	112年	113年	114年H1
營業收入	1,436,376	1,156,095	1,519,950	674,799
營業成本	1,103,544	896,902	1,181,635	515,406
營業毛利	332,832	259,193	338,315	159,393
營業費用	261,698	250,917	266,211	127,567
營業淨利	71,134	8,276	72,104	31,826
營業外收入及支出	2,950	9,001	6,807	(4,168)
稅前淨利(損)	74,084	17,277	78,911	27,658
本年度淨利	58,635	10,823	63,930	23,468
每股盈餘	3.26	0.60	3.16	1.06

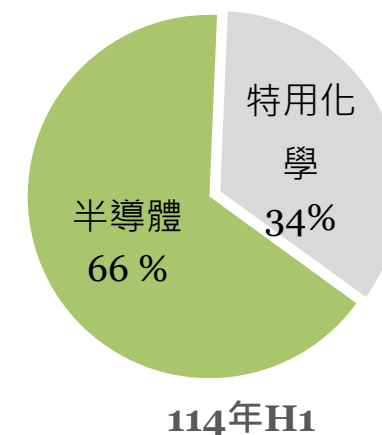
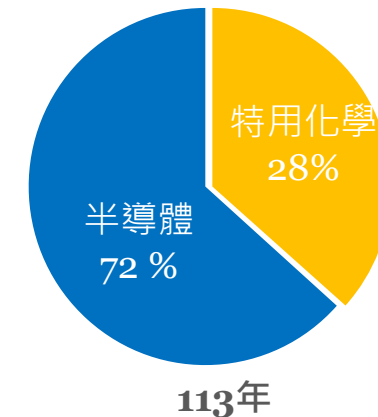
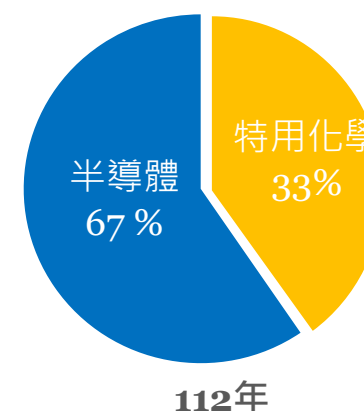
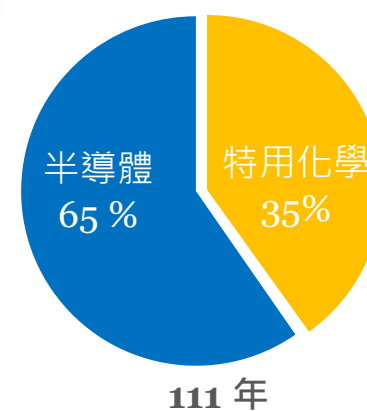


營收與部門別資訊

單位：新台幣仟元



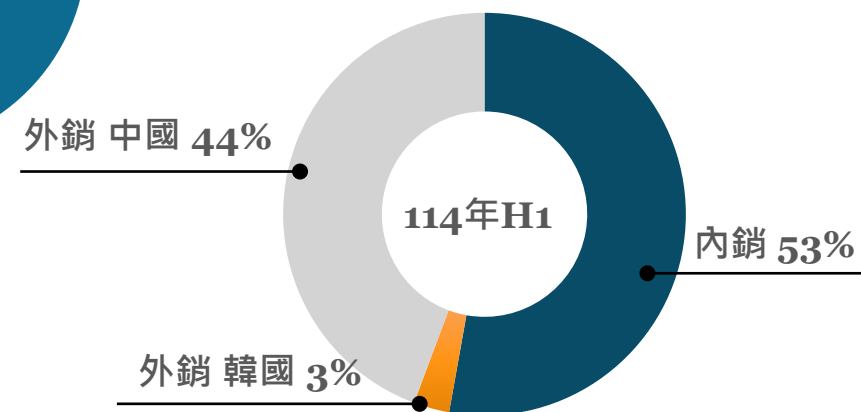
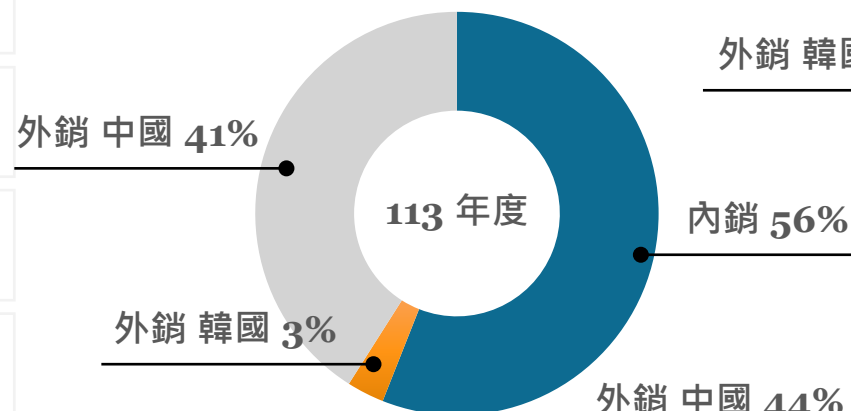
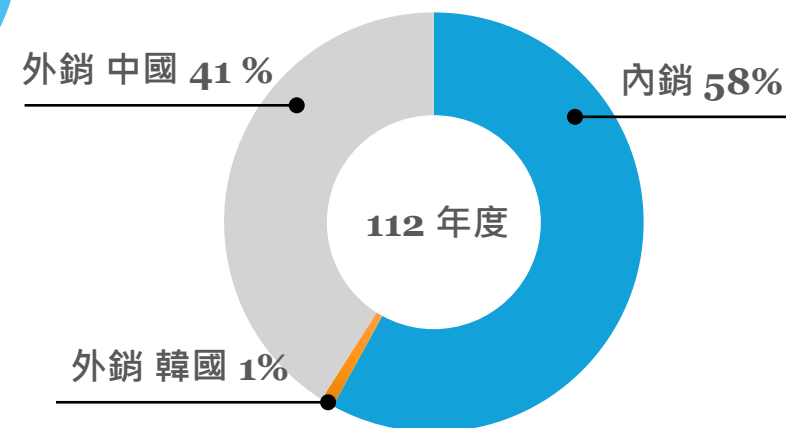
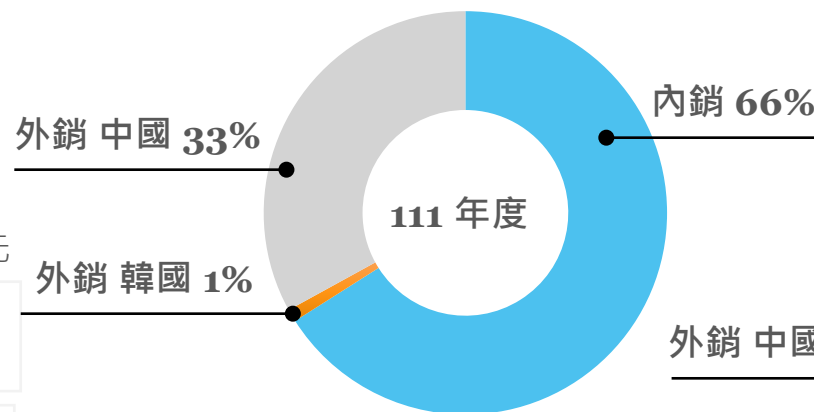
	111年	112年	113年	114年H1
營業收入	1,436,376	1,156,095	1,519,950	674,799
營業成本	1,103,544	896,902	1,181,635	515,406
營業毛利	332,832	259,193	338,315	159,393
營業費用	261,698	250,917	266,211	127,567
營業淨利	71,134	8,276	72,104	31,826
營業外收入及支出	2,950	9,001	6,807	(4,168)
稅前淨利(損)	74,084	17,277	78,911	27,658
本年度淨利	58,635	10,823	63,930	23,468



＝ 內外銷資訊及占比

單位：新台幣仟元

	111年	112年	113年	114年H1
內銷	949,190	674,430	857,543	355,490
外銷	487,186	481,665	662,407	319,309
中國	473,371	468,209	615,466	298,193
韓國	13,300	12,870	46,129	19,364
其他	515	586	812	1,752



＝ 股利發放政策

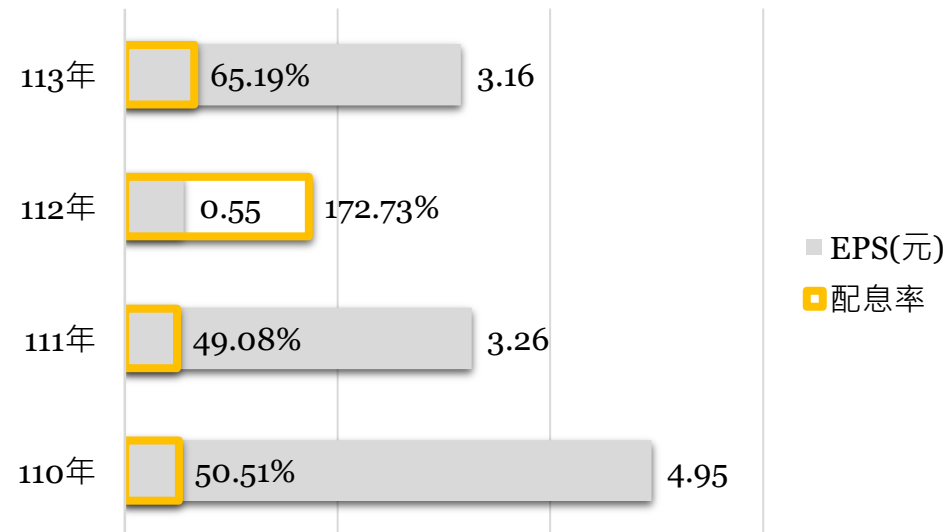


股票代號 7858

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘、股利為新台幣元外)

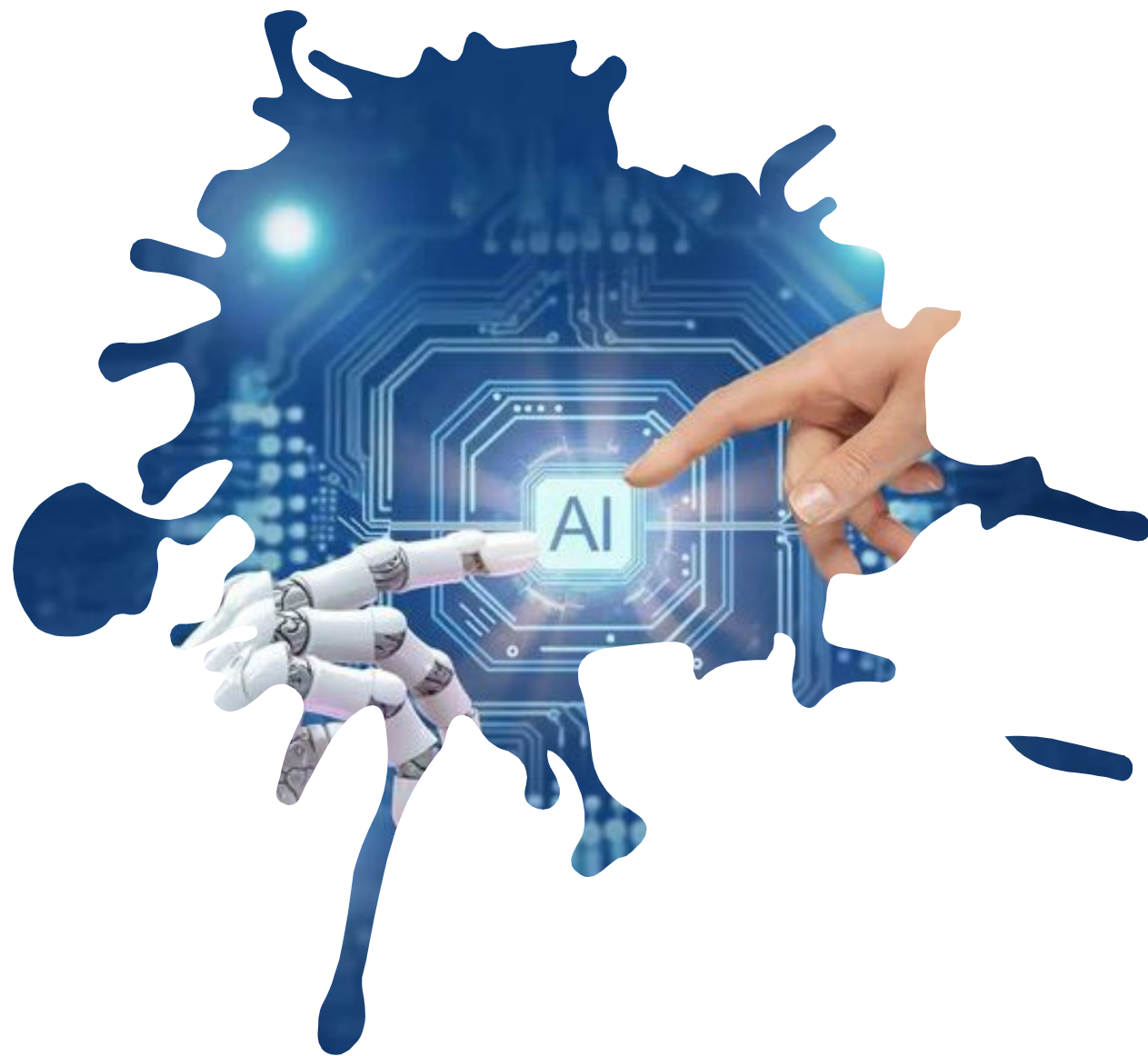
	110年	111年	112年	113年
本年度淨利	89,052	58,635	10,823	63,930
股本	179,998	179,998	179,998	206,987
EPS(元)	4.95	3.26	0.55	3.16
現金股利	2.5	1.6	0.45	1.41
股票股利				
資本公積轉增資	-	-	0.50	-
盈餘轉增資	-	-	0.50	0.65
配息率	50.51%	49.08%	172.73%	65.19%

不含公積轉增資



依本公司章程規定，年度總決算如有盈餘，應(i)提繳稅款；(ii)撥補以往虧損；(iii)依法提列百分之十為法定盈餘公積，但累計法定盈餘公積達本公司實收資本額者不在此限，如尚有盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議後分派之。

本公司股利政策，就當年度未分配盈餘提撥不低於百分之二十分配股東股息及紅利，其餘為未分配盈餘；惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之三十時，得不予分配。分配股東股息及紅利時得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額的百分之三十，但得視當年度實際獲利及資金需求狀況，經股東會決議調整之。



=

Q & A



股票代號 7858

Thanks



01

芝普法說會簡報



02

研究報告



03

芝普興櫃登錄新聞稿